

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年8月12日(2021.8.12)

【公開番号】特開2020-47760(P2020-47760A)

【公開日】令和2年3月26日(2020.3.26)

【年通号数】公開・登録公報2020-012

【出願番号】特願2018-174833(P2018-174833)

【国際特許分類】

H 01 L 21/52 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/52 F

【手続補正書】

【提出日】令和3年7月1日(2021.7.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項9】

請求項8の半導体装置の製造方法において、

前記(c)工程は前記ダイシングテープ上のダイを前記ボンディングヘッドでピックアップし、

前記(d)工程は前記ボンディングヘッドで前記ピックアップしたダイを前記基板または既にボンディングされたダイの上にボンディングする半導体装置の製造方法。